

公司代码：688172

公司简称：燕东微

北京燕东微电子股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”四、风险因素。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	燕东微	688172	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
----------	-----------------	--------

姓名	霍凤祥	赵昱琛
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路51号	北京市北京经济技术开发区经海四路51号
电话	010-50973019	010-50973000-8543
电子信箱	bso@ydme.com	zhaoyc@ydme.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务包括产品与方案和制造与服务两大类。公司主要市场领域包括消费电子、电力电子、新能源和特种应用等。公司产品与方案板块的产品包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件。公司制造与服务板块聚焦于提供半导体开放式晶圆制造和封装测试服务。目前拥有一条 8 英寸晶圆生产线和一条 6 英寸晶圆生产线，正在建设一条 12 英寸晶圆生产线。截至 2022 年年底，8 英寸晶圆生产线产能达到 5 万片/月，6 英寸晶圆生产线产能达到 6.5 万片/月，12 英寸晶圆生产线正在按计划建设过程中；6 英寸 SiC SBD 产品处于小批量量产，1200V SiC MOSFET 首款样品在性能评测中。

(二) 主要经营模式

公司产品与方案板块主要采用 IDM 经营模式，即自身体系内包含芯片设计、晶圆制造、封装测试中全部或主要业务环节，并通过经营上述环节最终为客户提供具体的产品与解决方案，主要产品包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件；制造与服务板块业务主要是公司接受其他半导体企业委托，提供晶圆制造或封装测试环节的专业化服务。

1. 研发模式

公司制定了包括内控制度《产品研究与开发管理办法》和流程控制文件《设计和开发控制程序》等在内的研发管理制度，并根据实际执行情况持续完善更新，全面覆盖了研发的各个阶段。

针对产品与方案板块：

(1) 可行性研究（立项）阶段

战略管理部门或市场部门根据行业内的技术产品发展趋势及对客户新产品需求的判断，提出新产品开发项目（以下简称“新品项目”）的需求。公司组建跨职能小组对新产品的各种要求进行综合评估，如果达到公司立项条件，则根据相应的管理流程履行立项审批，同时指定该产品开发的项目负责人，进行后续的新产品开发项目。若该项目对公司未来发展有重要影响力，则纳入公司级科研项目计划，由公司项目管理办公室来稳步推进和协调项目的进度和交付。

(2) 产品设计和样品试制阶段

新品项目立项后，项目负责人负责组建项目组（包括但不限于产品设计、生产组织、过程监控及可靠性验证以及客户验证等人员）并进行项目的任务分解，确定新产品开发计划以及关键里程碑节点。生产运营部门根据项目组要求制定样品试制计划并组织样品试制，待新品样品产出后，由质量部门协同设计人员制定并组织实施相应检验和可靠性验证方案，样品检验合格后，通知市场部门安排客户试用。新产品样品经客户认证通过后，通过跨职能项目小组评审后可转入试生产阶段。

(3) 试生产阶段（小批量生产）

新产品进入试生产阶段后，由新品项目负责人协同相关部门编制小批量试生产计划，在试生产过程中，新品项目组负责组织收集小批量试生产的过程中的各类技术和良率参数和成本参数等信息，待试生产完成后，组织会议评审试生产是否合格、能否转入下一阶段中批量或正式量产进行评审；若评审不通过，则重新安排新品小批量试制，若评审结论是中批量试产，则按照小批量

过程管理执行；若评审结论是正式量产，则将该产品纳入公司的产品交付清单，按照正常的业务模式执行。

针对制造与服务板块：

（1）可行性研究（立项）阶段

制造与服务板块与产品与方案板块的立项阶段流程基本相同，只是在实际开发过程中考虑的各种生产要素和交付物存在差异。

（2）新平台开发阶段

新品项目负责人根据项目目标任务，组建项目团队，制定项目开发计划，配置项目需求的各项资源，组织实施项目开发工作。以晶圆制造为例，新产品平台开发阶段的工作包括新平台设计规则的确定、Etest 测试图形设计、工艺流程和工艺规范设计、样品掩膜版的制作、新产品实验方案确认、单项工艺开发、新平台样品试制等，样品合格后提取器件模型，建立模型库及全套设计服务文件。

（3）新产品验证阶段

将新平台模型库及设计服务文件提交给客户用于客户产品设计，产品导入后由产品技术部门进行新产品样品试制，新产品样品批工艺参数和器件参数合格后提交给设计公司进行功能验证。产品验证合格后，由产品技术部门进行新产品样品试制总结，经产品质量先期策划小组评审合格后转入试生产阶段。

（4）试生产阶段

新产品验证合格后，进入试生产阶段，由产品技术部门进行良率提升、工艺过程能力提升和产能提升。试生产各项指标达成后，由新产品开发项目负责人对试生产阶段的各项工作进行总结，经产品质量先期策划小组评审合格后转入量产阶段。

2.采购与生产模式

公司基于 ISO 体系标准并结合公司经营管理的需要，建立了完善的内控管理体系和过程监督体系，制定了包括但不限于《生产运营管理办法》《产成品委外管理办法》《生产监控管理办法》《采购管理办法》《价格管理办法》《物资仓库管理办法》《供应商管理办法》《质量检验管理制度》《安全生产管理制度》《不合格品管理办法》以及配套的管理程序或实施细则等制度文件体系，有效管理生产运营过程中的各类风险。

（1）采购模式

①采购实施

采购实施过程主要严格按照公司《采购管理办法》及实施细则规定进行，采购方式会根据采购的物资对象采用不同的方式，其中生产用材料主要从公司的合格供应商名录中选取合格供应商，然后采购部门大多根据年度供应商评价结果与供应商签署年度采购框架协议，公司根据生产需求并结合当期在途及在库等因素制定采购计划，采购部门依据采购计划执行采购，并通过采购订单的方式进行信息传递和过程约束。

②供应商管理

供应商管理严格按照《供应商管理办法》执行，包括但不限于供应商开发、供应商甄选、供应商评价以及合格供应商名录管理等内容。供应商甄选是其中的核心控制环节，尤其是生产用原材料的供应商有严格的供应商的导入认证程序和评价标准，合格后纳入合格供应商名录。供应商评价方面，原则上每年度供应商管理部门会组织相关部门针对供应商的技术水平、资质、价格、质量体系及物流管理等要素进行综合评价。其中生产用材料的核心制造供应商，还需要由质量管理部门组织相关人员进行现场审核，综合评价其综合交付能力，有利于有效保证产品质量及产能需求。

为了同时与供应商保持长期稳定的合作关系，保障公司稳定生产，公司不定期召开专题会议讨论包括但不限于企业战略规划，企业生产经营状况和未来需求等内容。

③采购价格管理

采购价格管理主要参照公司《价格管理办法》和《采购管理办法》执行，时刻了解市场行情，对主要原材料价格变动制定相应的采购策略，争取最优价格。

④入库检验

入库检验环节严格按照《物资仓库管理办法》及相关制度执行。采购人员根据物资到货计划来协调仓库管理部门进行数量及外观清点，并进行收货。若该物资需要进行质检合格后入库，则还会由质量部门按照技术规范对原材料进行检验合格后方可入库，对于检验不合格的物料，公司会进行标识、单独分区域存放并按照不合格品管理规定进行处理。

(2) 生产模式

①产品与方案板块

对于分立器件及模拟集成电路，公司以自身的全流程制造资源为基础，采用 IDM 模式经营，多年以来在消费电子、电力电子等领域公司积累了丰富的产品设计经验，产品在自有 6 英寸和 8 英寸晶圆生产线上进行生产，并委托外协封测厂利用公司自有产权设备进行封装测试。

对于特种集成电路及器件，公司通过自有生产线自行完成产品的封装和测试，依据相关严格标准进行加工，产出满足客户要求的产品。

公司市场部门根据市场及客户需求制定销售计划，生产运营部门根据销售计划、库存信息、设备产能、停机保养计划等制定生产计划，生产制造部门根据生产订单实际安排生产作业过程，以满足生产产出需要。

②制造与服务板块

公司采取“以销定产”的生产模式。

对于晶圆制造业务，生产运营管理部门会结合市场需求、物料供应、标准生产周期等因素制定生产计划，并组织相关部门评审。通过评审后，公司将主生产计划下达至生产制造部门。生产制造部门会根据该计划，分解生产作业计划安排，结合设备设施情况、物料到货计划以及人员配置等情况，合理安排保证按照计划和标准生产节奏进行产出。质量部门会对生产全过程的质量进行监督管理，并进行生产线关键工艺检验，并对完成加工制造的产品进行良率和外观等入库前检验或出厂前检查，确保入库产品为合格品。

对于封装测试业务，公司均采用委托外协封测厂进行封测的模式，公司不定期派出质量工程师对工厂质量控制情况进行稽核，协助提升产品品质。外协封测厂负责组织人员利用产线进行封装测试、日常设备维护等日常运营工作。公司市场部门在接到客户封装加工订单后，传递给产品运营部门，产品运营部门根据封装设备产能情况、材料准备情况，向外协封测厂下达委托加工订单，同时将客户的芯片发给外协封测厂。外协封测厂根据委托加工订单要求进行封装加工、测试、包装和入库，生产完成后按订单要求进行运输包装、出库并发货给客户。

公司现有封测服务的封测技术均来源于公司自身。公司掌握了超小芯片高精度芯片粘片技术，可实现超小尺寸芯片（0.19*0.19mm）的高速粘片；掌握了超低线弧键合技术；掌握了超小 Pad 尺寸键合技术，可实现最小厚度 300 μ m 的超薄封装；掌握了高密度焊线、超长线弧、大转角线弧等焊线技术，可有效缩小管脚间距，进行多引脚封装；掌握了多芯片粘片技术、多层线弧控制技术，可实现多引脚集成电路封装。

3.销售模式

公司制定了《销售管理办法》《客户评价管理办法》《销售发票管理细则》，具体的规定和流程见下：

(1) 客户导入及其授信：市场部门收集即将发生业务的客户信息，包括但不限于公司营业执照、开票资料、其他商务信息等，并将信息录入内部系统，如客户是授信客户，通过内部流程审批后为客户分配信用额度和信用账期，审批通过后完成客户导入。

(2) 报价：遵守市场原则，市场部门提交报价申请，审批后出具报价单发送给客户确认，双方达成一致后执行。

(3) 接受订单与计划：市场部门将客户订单录入内部系统，包括规格型号、订单数量、价格、交货日期等，市场部门内部相关部门根据现有在制品或者库存情况确认可交付的日期并回复客户。市场部门根据客户的预测计划，形成滚动的市场需求计划，提交内部相关部门评审，生产部门按需求组织生产。

(4) 发货：对于非授信客户，公司财务确认收到客户货款后进行发货；对于授信客户，在其授信条件内发货。发货时产品直接由公司发送至客户指定地点。

(5) 销售对账及开票：市场部门定期与客户进行销售对账，双方确认后，市场部门在系统中生成发票，相关业务部门根据系统发票和市场部门提供的开票信息开具发票，市场部门审核后开发票寄送给客户。

(6) 收款：对于非授信客户，公司在发货前收取货款；对于授信客户，市场部门按照相应的信用账期在发货后跟踪货款结算情况，以促进按期回款。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等服务，属于半导体行业。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主要产品或服务属于“1 新一代信息技术产业——1.2 电子核心产业——1.2.4 集成电路制造”；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司主要产品或服务属于“1 新一代信息技术产业——1.3 电子核心产业——1.3.1 集成电路”。

近年来，在市场需求带动下，以及国家相关政策支持下，我国集成电路产业整体实力显著提升，集成电路设计、制造、封装测试、装备及材料等产业链各环节快速发展，已初步具备参与国际市场竞争、支撑信息技术产业发展的基础。国家相关支持政策明确了集成电路行业在国民经济中的战略地位。上述政策和法规的发布和落实，从定位、导向、财政、税收、技术和人才等多个方面对集成电路行业给予了大力支持，也将持续为公司主营业务的发展提供积极的政策环境，助力公司发挥自身优势，不断提高产品的核心竞争力。其中《国家集成电路产业发展推进纲要》指出：到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队。上述政策法规的发布和落实，为半导体产业的发展提供了良好的政策环境，推动了半导体产业在近年来迅速发展。

2022年2月，教育部、财政部、发改委联合发布《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》，提出加强集成电路、人工智能等领域人才的培养；2022年3月，国家发改委、工信部等五部门联合发布《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》支持集成电路产业发展。综合来看，国家持续对半导体产业推出各项鼓励政策，站在国家战略高度对产业的发展提出顶层规划，自上而下地进行多角度、全方位的扶持，加速半导体产业的发展。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务包括产品与方案和制造与服务两类业务。公司产品与方案业务聚焦于设计、生产和销售分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件；制造与服务业务聚焦于提供半导体开

放式晶圆制造与封装测试服务。公司主要市场领域包括消费电子、电力电子、新能源和特种应用等。

产品与方案业务方面，经过多年积累，公司在多个细分领域布局，形成了系列化产品。公司数字三极管产品门类齐全、精度高，2022年出货量达22亿只以上；公司拥有二十余年声学传感器领域元器件设计和制造经验，是国内主要的ECM前置放大器出货商，2022年出货量达33亿只以上，目前最薄产品厚度仅有0.3mm，可以支持客户对减少放大器体积、增大声腔空间的要求；公司浪涌保护器件电容值最低可达0.2pF，广泛用于高速数据传输端口中，2022年出货量超26亿只，其中低电容产品占比超过15%；公司拥有从20V-100V的全电压射频工艺制造平台，可制造包括射频LDMOS、射频VDMOS、高频三极管在内的满足不同功率要求的高频器件，年出货量超过5200万只。在特种集成电路及器件应用领域，公司已深耕数十年，是国内最早从事特种光电、特种分立器件、特种CMOS逻辑电路、特种电源管理电路和特种混合集成电路研制的企业之一。产品主要功能为信号的采集、处理、控制、传输，具有工作温度范围宽、抗盐雾、耐湿热、抗机械冲击、环境适应性强等特点，广泛应用于仪器仪表、通信传输、遥感遥测、水路运输、陆路运输等特种领域。公司具备较为完善的设计制造、封装测试、可靠性试验、失效分析和质量评价基础能力，是国内重要的特种集成电路及器件供应商。

制造与服务业务方面，公司已通过ISO14001、ISO45001、ISO9001、IATF16949等体系认证，具备为客户提供规模化制造服务能力。晶圆生产线，已建成平面MOSFET、沟槽MOSFET、平面IGBT、沟槽IGBT、BCD、MEMS、BJT、TVS、JFET、SBD、FRD、模拟IC等工艺平台，2022年累计产出103.77万片。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）国家大力支持半导体产业发展

半导体产业是信息技术产业的核心，也是经济发展的支柱性产业，在实现制造业升级等方面发挥着重要的作用。但我国半导体自给率偏低，长期依赖于进口。在我国经济社会发展需求和全球贸易争端的背景下，半导体产业得到了国家和社会各界越来越多的重视。近年来，国家为支持半导体产业发展，出台了一系列财税减免、产业规划、知识产权保护相关的政策法规，具体包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等，上述政策法规为业内企业的发展提供了充分的保障和支持，为行业发展注入了新动能。

（2）市场增速放缓，需求结构性转变

根据美国半导体行业协会（SIA）发布的2022年半导体市场数据显示，2022年全球半导体销售额达到5,735亿美元，与2021年的5,559亿美元相比增长了3.2%。2022年四季度全球半导体销售额达到1,302亿美元，比2021年第四季度的销售额减少了14.7%，比2022年第三季度的销售额减少了7.7%。2022年中国仍是最大的半导体市场，年销售额达1,803亿美元，但与2021年相比下降了6.3%。

半导体市场呈现分化趋势，传统消费电子产品需求放缓，新能源汽车、AIoT等新技术、新应用领域增速依然强劲，功率器件、模拟芯片、MCU、电源管理等需求增长。长期来看，随着5G、AIoT、自动驾驶、VR/AR等新一轮科技逐渐走向产业化，以及国产化程度的逐步提高，我国半导体产业仍处于重要的战略机遇期。

（3）加强自主产业生态建设

随着“逆全球化”和对我国高科技产业遏制的持续发展，我国半导体产业发展面临巨大的技术升级的挑战和产业安全风险。国家将致力于构建本地安全供应链，助力本国半导体自主能力，避免供应链过度依赖而造成的问题。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新

发展格局，加强自主产业生态建设、加速推进国产化替代的进程，成为半导体产业重要的发展趋势。

(4) 供需逐渐趋于平衡

2021年全面缺芯导致产业链各环节库存高启，2022年下半年需求下滑，与高库存形成叠加效应，导致市场形势急转而下。随着时间的推移和宏观经济向好，库存逐渐消化，需求逐步回暖，预计2023年半导体产业供需将逐步趋于平衡。在新能源汽车、工业等领域需求增长带动下，芯片需求将呈现向好态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	17,824,653,931.58	13,072,659,260.91	36.35	7,438,766,409.16
归属于上市公司股东的净资产	14,348,604,152.99	10,129,796,126.78	41.65	5,052,922,815.2
营业收入	2,175,224,334.82	2,034,699,554.29	6.91	1,030,495,692.04
归属于上市公司股东的净利润	462,125,789.66	550,444,957.65	-16.05	58,490,504.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,522,471.61	385,384,252.72	-5.41	-33,090,407.77
经营活动产生的现金流量净额	796,394,617.50	441,608,214.31	80.34	387,836,894.05
加权平均净资产收益率(%)	4.46	8.49	减少4.03个百分点	1.17
基本每股收益(元/股)	0.45	0.78	-42.31	-
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.78	-42.31	-
研发投入占营业收入的比例(%)	7.96	7.98	减少0.02个百分点	17.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	573,350,439.25	582,777,417.00	580,616,759.57	438,479,719.00
归属于上市公司股东的净利润	150,804,365.41	155,377,148.20	131,730,268.13	24,214,007.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,532,881.28	132,873,054.02	121,257,866.31	-17,141,330.00
经营活动产生的现金流量净额	69,558,851.60	366,707,019.49	115,245,682.15	244,883,064.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	53,678							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,709							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、标记 或冻结情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	

北京电子控股有限责任公司	0	420,573,126	35.07	420,573,126	420,573,126	无	0	国有法人
北京亦庄国际投资发展有限公司	0	168,912,889	14.09	168,912,889	168,912,889	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	113,014,423	9.42	113,014,423	113,014,423	无	0	国有法人
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	0	101,104,235	8.43	101,104,235	101,104,235	无	0	其他
天津京东方创新投资有限公司	0	93,164,110	7.77	93,164,110	93,164,110	无	0	国有法人
盐城高新区投资集团有限公司	0	45,205,769	3.77	45,205,769	45,205,769	无	0	国有法人
北京电子城高科技集团股份有限公司	0	22,602,884	1.88	22,602,884	22,602,884	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	22,354,647	1.86	22,354,647	22,354,647	无	0	国有法人
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	17,074,784	17,074,784	1.42	17,074,784	17,074,784	无	0	国有法人
产业投资基金有限责任公司	14,228,987	14,228,987	1.19	14,228,987	14,228,987	无	0	国有法人

北京京国瑞股权投资基金管理有限公司—北京京国管股权投资基金（有限合伙）	14,228,987	14,228,987	1.19	14,228,987	14,228,987	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无					

存托凭证持有人情况

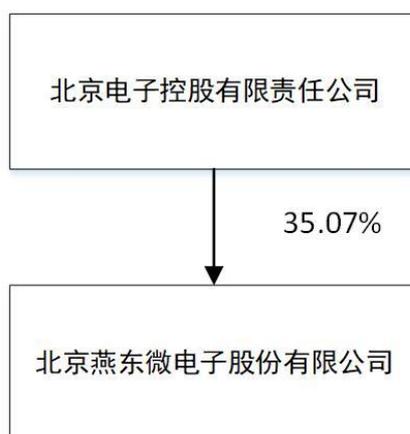
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

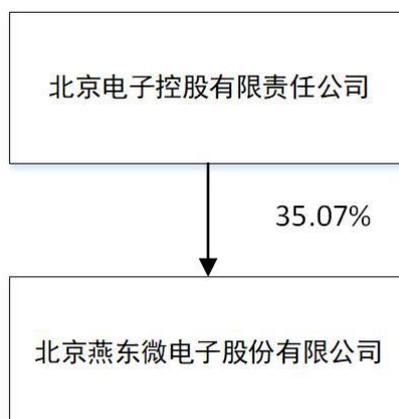
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 217,522.43 万元，较上年同期增长 6.91%；实现利润总额 52,751.79 万元，较上年同期下降 19.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 46,212.58 万元，较上年同期下降 16.05%；报告期末公司总资产 1,782,465.39 万元，较期初增长 36.35%；归属于母公司所有者权益为 1,434,860.42 万元，较期初增长 41.65%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用